

株主メモ

事業年度	毎年4月1日から翌年3月31日まで
定時株主総会	毎年6月開催
基準日	期末配当金 毎年3月31日 中間配当金 毎年9月30日 そのほか必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日
単元株式数	100株
株主名簿管理人および 特別口座の口座管理機関	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社
株主名簿管理人 同事務取扱場所 (郵便物送付先)	東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部 〒168-0063東京都杉並区和泉二丁目8番4号 三井住友信託銀行株式会社 証券代行部
(電話照会先)	☎0120-782-031
(インターネットホームページURL)	http://www.smtb.jp/personal/agency/index.html
公告の方法	当社のホームページに掲載する http://www.ferrotec.co.jp/
上場証券取引所	株式会社東京証券取引所 JASDAQスタンダード

・株式に関する住所変更等のお届出およびご照会について

証券会社の口座をご利用の場合は、三井住友信託銀行ではお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。証券会社の口座のご利用がない株主様は、上記電話照会先までご連絡ください。

年間IRカレンダー

第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
	決算発表 決算説明会	株主総会	第1四半期開示	第2四半期決算		第2四半期決算発表 第2四半期決算説明会			第3四半期開示		本決算

FerroTec

株式会社 フェローテックホールディングス

〒103-0027

東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階

TEL 03-3281-8808 FAX 03-3281-8848

URL <https://www.ferrotec.co.jp/>

UD FONT

見やすいユニバーサルデザインフォントを採用しています。



森林に配慮して適切に管理された森林認証紙を使用しています。



環境に配慮した植物油インキを使用しています。

第38期 第2四半期決算報告

平成29年4月1日～平成29年9月30日

証券コード：6890



FerroTec

株式会社 フェローテックホールディングス

株主の皆様へ



代表取締役社長
山村 章

平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

ここに第38期第2四半期決算報告をお届けするにあたりご挨拶申し上げます。

現在、当社グループでは、主力事業である半導体・FPD業界を中心とした半導体等装置関連事業と広範囲な業界に対応する電子デバイス事業の業容拡大を目的とした設備投資を実行中です。

昨今の半導体業界は、微細化投資や3Dナンドフラッシュメモリーの量産に向けた設備投資等の活性化により、各社とも高い受注水準にあります。またFPD業界では有機ELパネルの設備投資が旺盛です。データセンター記憶媒体のオールフラッシュ化に伴うメモリの大幅増産や、IoTの発展に伴うセンサー、通信チップなど半導体市場の急激な成長に加えEV自動車に搭載する電子部品など、今後も同業界では設備投資と稼働率の活性化が見込まれます。

当社は半導体業界向けに、半導体製造装置に欠かせない真空シールや、半導体製造工程において使用される治具・消耗品であるマテリアル製品(石英・セラミックス・CVD-SiC)、半導体の材料となるシリコンウェーハ等を取り扱っておりますが、好調な市場の動向を背景として、顧客から強い製品需要に伴う増産の要望が相次いでおり、各製品の増産体制を実現すべく、設備投資を目的とした資金調達を実施し、9月に終了致しました。

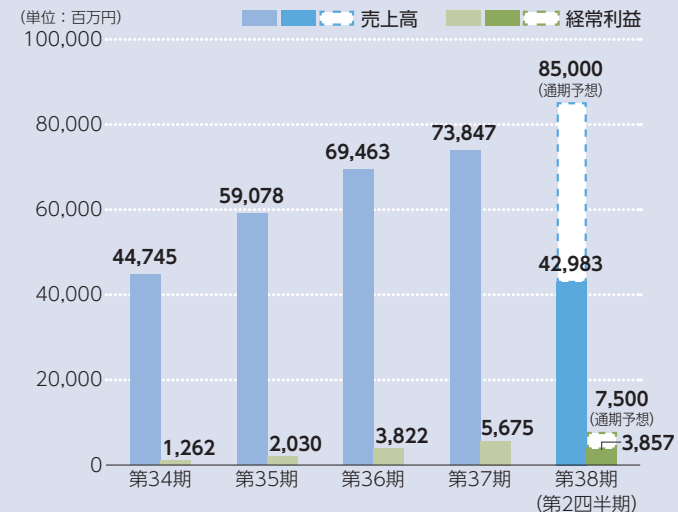
今般の資金調達により当社の更なる成長と安定的な財務体質の構築を実現し、一層の経営安定化と企業価値の向上を図ることで、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの利益の最大化に努めて参ります。

株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

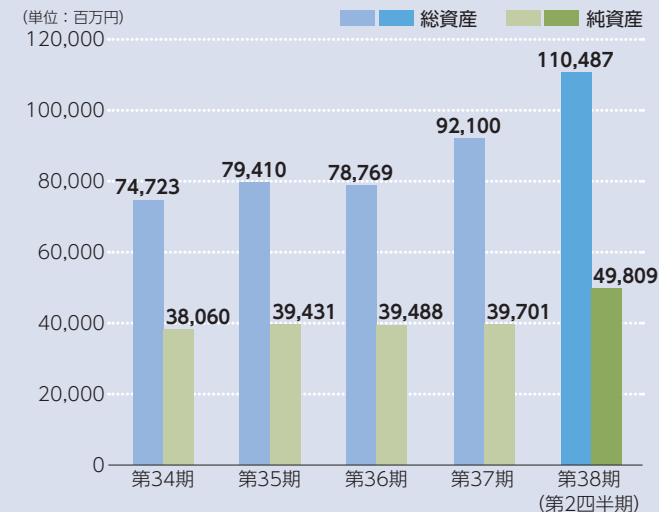
平成29年12月吉日

財務ハイライト

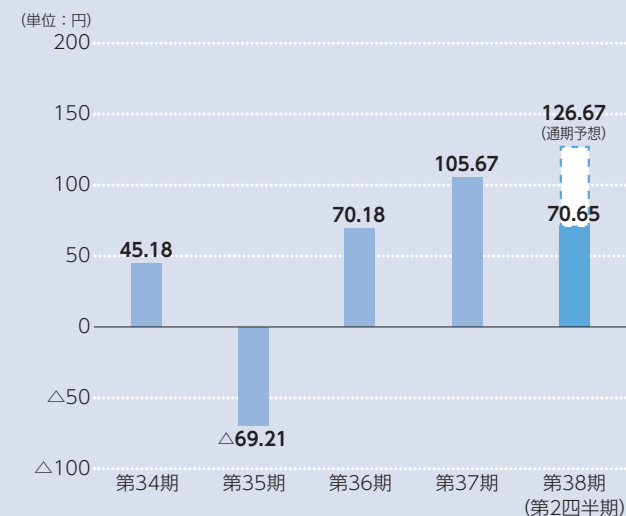
売上高／経常利益



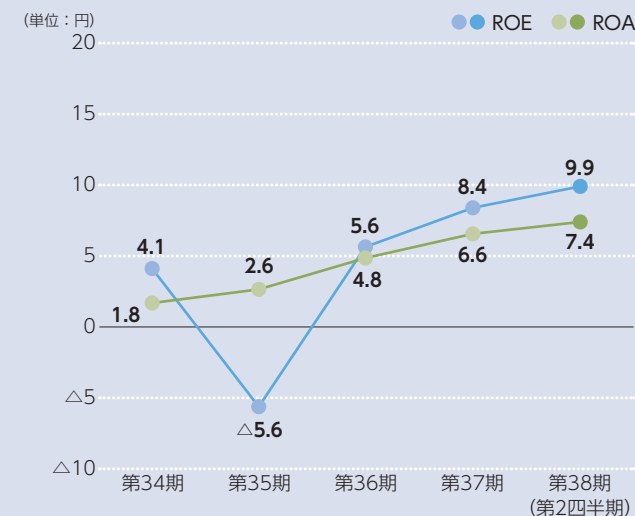
総資産／純資産



1株当たり当期(四半期)純利益



ROE(自己資本当期純利益率)／ROA(総資産経常利益率)



※第38期については、通期業績予想数値をベースにしています。

半導体向け 8インチシリコンウェーハ



- 1 2017年7月 銀川・上海両工場開業式実施
- 2 2018年1月から量産開始予定、2019年度中に月産45万枚体制構築
- 3 参入背景
 - IoT/車載センサーなどの普及で8インチ需要大幅増
 - 政府主導の中国製造2025 自給率向上プロジェクト(補助金有)

第一期

生産能力：月産15万枚(2018年1月以降量産開始)
生産拠点：銀川(インゴット～ウェーハ・スライス工程)
 上海(ポリッシュドウェーハ仕上げ工程)

第二期

生産能力：月産30万枚(2019年上期中～量産開始)
生産拠点：銀川(インゴット～ウェーハ・スライス工程)
 杭州(ポリッシュドウェーハ仕上げ工程)

中国の主要生産拠点

銀川(寧夏)

生産品目
 半導体用インゴット
 スライスウェーハ



上海

生産品目
 半導体用ウェーハ



杭州

生産品目
 半導体用ウェーハ



ファイン・セラミックス

(半導体前工程製造装置用部材)



- 1 2017年9月 杭州江東工場開業式実施(杭州エリアでの増産を実施)
- 2 2017年9月から量産開始(生産能力前年比5割増)、来期 更に3-4割増(予定)
- 3 増産背景
 - スマホ高速大容量化、サーバー系投資旺盛でメモリー需要拡大
 - 3D-NAND向けエッチング装置用消耗部材の需要が拡大基調



2017年9月28日 杭州江東工場開業式の様子

CVD-SiC

(半導体前工程製造装置用部材)



- 1 2017年7月 韓国工場開業式実施(これまでは岡山工場のみで量産)
- 2 2018年1月から量産開始予定、当製品来期生産能力前年比5割増(予定)
- 3 増産背景
 - ロジック系微細化プロセス増加を受け、耐熱性、耐摩耗性に長けたSiC需要増加
 - 3D-NAND向けエッチング装置用消耗部材としても、コンタミフリーのSiC需要が拡大中



韓国工場の外観

冷熱素子(サーモモジュール)

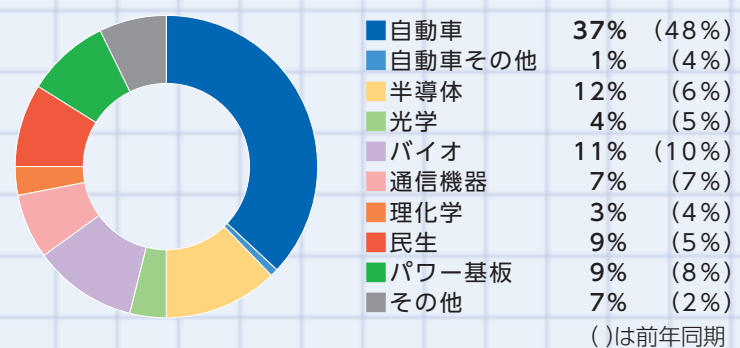
通信、自動車分野での成長ポテンシャルに注力



サーモモジュール単品

- 製品説明** 直流電流を流すと一方の面が吸熱(冷却)し、反対の面が放熱(加熱)する原理を利用した半導体素子で、電流により、発熱・吸熱を制御出来る。
- 主な最終製品は、自動車温調シート、家電製品(ヘッドライヤー、美顔器・他)、バイオ(DNA増幅装置、血液分析装置)、通信機器、冷却チラーなど多岐業種に渡る。
 - モバイルデータ通信の規格変更(→5G)で、需要拡大が見込める通信機器分野での拡販
 - グローバルな電気自動車の普及拡大に伴う関連製品での新用途開拓
 - ユニット製品販売を本格化し、売上・営業利益の更なる拡大
- 成長戦略**

サーモモジュールの業種別販売先シェア



サーモモジュール ユニット

パワー半導体用基板

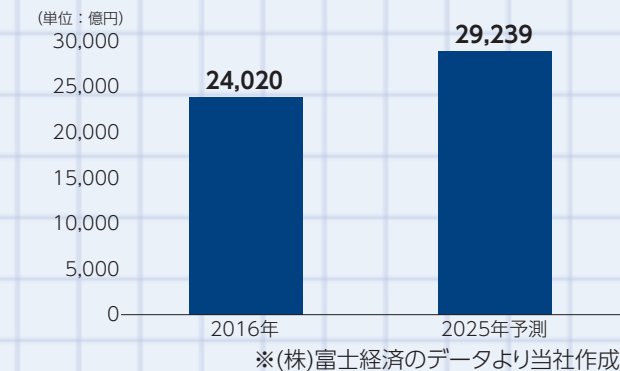
EV・産業機器分野での成長ポテンシャルに注力



パワー半導体基板

- 製品説明** アルミナ、窒化アルミニウムセラミックスに銅回路板を共晶反応によって接合した放熱用絶縁基板。
- 主なアプリケーションは、電車・電動車両・エアコン・生産設備などの小型化、省エネ化
 - 世界的な電気自動車普及拡大トレンドの中、IGBTモジュールを中心に需要拡大が見込まれ、日本、欧州、中国各社への拡販に注力
 - 消費電力抑制気運の中、家電、生産設備のインバーター化の流れに乗り、生産能力拡大に取り組み、3年で3倍程度の売上拡大を目標に。
- 成長戦略**

パワー半導体の世界市場



電気自動車

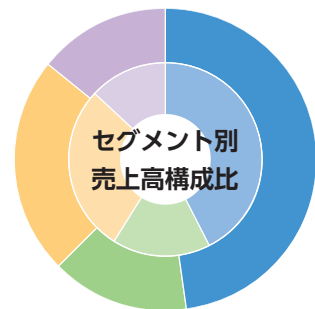
主力5製品の分野別 アプリケーション・マトリックス

当社の主力5製品を利用して開発された
身近にある製品を分野別にご紹介します。

● 当社製品が最終製品に直接使用されているケース
■ 当社製品が最終製品の製造工程で使用されているケース

製品			自動車産業分野	エレクトロニクス産業分野	家電民生品分野	医療分野
真空シール	装置関連 (半導体、FPD、LEDなど)		各種センサー CCD ■	スマホ パソコン画面 ■	液晶テレビ ■	CTスキャン MRI ■
石英	装置関連 (半導体、FPD、LEDなど)		各種センサー CCD ■	フラッシュメモリ CPU・LED ■	液晶テレビ ■	
セラミックス	装置関連 (半導体、FPD、LEDなど)		フラッシュメモリ CPU・LED ■	フラッシュメモリ CPU・LED ■		外科用内視鏡 医療用超音波エコー装置 ●
サーモモジュール	電子デバイス (自動車、半導体、家電 民生、医療、光通信など)		温調シート ナビゲーションシステム カップホルダー 電力制御パワー半導体 (DCB基板) ●	冷却チラー 光通信 発電 ●	エアコン 空気清浄機 ワインセラー 美顔器 シェイバー ●	血液分析装置 DNA増幅器 生態試料検査装置 ●
磁性流体	電子デバイス (自動車、家電民生、医療 など)		カーオーディオ ●	スマートフォン (パイブレーション) ●	オーディオ TVスピーカー ●	バイオメディカル用 磁性ナノ粒子 ●

セグメント別事業概況



当社は、製品用途の類似性と販売先業種により区分し「半導体等装置関連事業」「電子デバイス事業」及び「太陽電池関連事業」の3事業を報告セグメントとしております。

半導体等装置関連事業 売上高 206億円 営業利益 35億円

半導体製造プロセスに使用されるマテリアル製品(石英製品、セラミックス製品、シリコンパーツ、CVD-SiC製品)は、スマートフォン、携帯端末やデータセンターなどに利用されるSSD(ソリッドステートドライブ)と称する記憶媒体などに、3次元NAND型フラッシュメモリの需要が逼迫しており、デバイスメーカー各社の設備稼働率が高水準であったため堅調に推移しました。各種製造装置の機能部品である真空シールは、半導体の微細化投資や有機ELパネルの製造設備用途の需要が強く堅調に推移し、サブアセンブリ品やチャンパー製品などの受託製造も堅調でした。



セラミックス製品



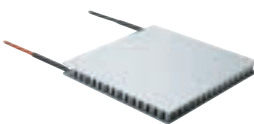
真空シール

電子デバイス事業 売上高 63億円 営業利益 15億円

主力の自動車温調シート向けのサーモモジュールは、北米市場での自動車販売台数が前年割れとなり軟調に推移しましたが、中国市場での販売台数が世界一となり、影響は限定的なものでした。一方、民生家電分野や中国における通信機器用途が堅調であり、医療検査装置、バイオ関連機器、半導体機器用途も底堅く推移したため、売上高は前年並みとなりました。パワー半導体用基板は、新たに欧州顧客から認定を得たため、増産体制を進めております。磁性流体は、スピーカー用途に加えスマートフォンのリニアバイブレーションモーターに採用されております。



磁性流体



サーモモジュール

太陽電池関連事業 売上高 99億円 営業利益 △6億円

太陽電池産業は、各国のCO2排出削減策の進行から、先進国に加え中国・インドを中心に新興国での需要が活発化しております。中国ではFIT(固定価格買取制度)が、6月末に当年度分の申し込みが終了しましたが、駆け込み需要の反動も少なく落ち着いています。今後は、EV車の普及に伴いパワーステーションの蓄電池用途などが検討されており、徐々に需要が拡大する局面が期待されています。当社製品も順調に出荷が進み収支は改善傾向となりましたが、過年度に販売した結晶製造装置ユーザーからの回収が長期化したことから貸倒引当金を計上し、加えて棚卸資産の評価損も計上したこと等により損失となりました。



太陽電池用セル



石英坩堝

※ 記載金額は、億円未満を切り捨てて表示しております。
各セグメントの売上高は、外部顧客に対する数値を記載しております。

連結財務諸表(要約)

連結貸借対照表

(単位:百万円)

科目	当第2四半期 平成29年9月30日現在	前期 平成29年3月31日現在
資産の部		
流動資産	66,493	51,245
固定資産	43,994	40,855
有形固定資産	37,947	34,294
無形固定資産	1,896	2,060
投資その他の資産	4,149	4,499
資産合計	110,487	92,100
負債の部		
流動負債	37,788	32,108
固定負債	22,889	20,290
負債合計	60,678	52,399
純資産の部		
株主資本	43,849	33,208
その他の包括利益累計額	5,408	6,015
新株予約権	14	23
非支配株主持分	536	453
純資産合計	49,809	39,701
負債純資産合計	110,487	92,100

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結キャッシュ・フロー計算書

(単位:百万円)

科目	当第2四半期 平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで	前第2四半期 平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,794	2,915
投資活動によるキャッシュ・フロー	△4,640	△2,779
財務活動によるキャッシュ・フロー	12,311	3,689
現金及び現金同等物に係る換算差額	△138	△1,298
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	12,327	2,526
現金及び現金同等物の期首残高	14,778	10,038
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)	60	—
現金及び現金同等物の四半期末残高	27,166	12,564

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結損益計算書

(単位:百万円)

科目	当第2四半期 平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで	前第2四半期 平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで
売上高	42,983	37,650
売上原価	30,689	27,556
売上総利益	12,293	10,094
販売費及び一般管理費	7,795	6,717
営業利益	4,498	3,376
営業外収益	255	323
営業外費用	896	1,592
経常利益	3,857	2,107
特別利益	—	2
特別損失	54	288
税金等調整前四半期純利益	3,802	1,821
法人税等	1,483	865
四半期純利益	2,319	956
非支配株主に帰属する四半期純利益又は非支配株主に帰属する四半期純損失(△)	19	△77
親会社株主に帰属する四半期純利益	2,299	1,033

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

連結包括利益計算書

(単位:百万円)

科目	当第2四半期 平成29年4月1日から 平成29年9月30日まで	前第2四半期 平成28年4月1日から 平成28年9月30日まで
四半期純利益	2,319	956
その他の包括利益	△608	△5,720
その他有価証券評価差額金	12	36
為替換算調整勘定	△626	△5,705
退職給付に係る調整額	6	6
持分法適用会社に対する持分相当額	△0	△58
四半期包括利益	1,711	△4,764
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	1,693	△4,619
非支配株主に係る四半期包括利益	18	△144

※ 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

株式情報 / 会社情報 (平成29年9月30日現在)

株式の状況

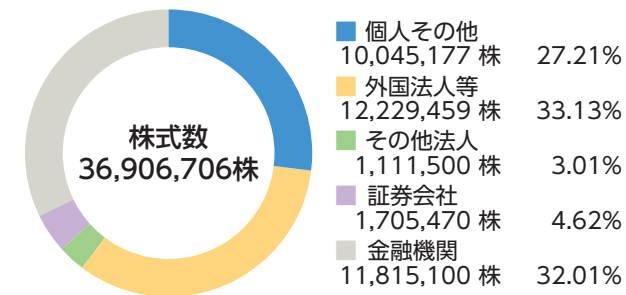
発行可能株式総数	67,000,000株
発行済株式総数	37,000,202株
株主数	14,090名

大株主

株主名	持株数(株)	持株比率(%)
日本トラスティサービス信託銀行株式会社(信託口)	4,892,200	13.22
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)	1,342,700	3.62
資産管理サービス信託銀行株式会社(年金信託口)	1,278,400	3.45
資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口)	961,600	2.59
BNYM SA/NV FOR BNYM FOR BNY GCM CLIENT ACCOUNTS M LSCB RD	954,400	2.57
RE FUND 107-CLIENT AC	870,057	2.35
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL	866,000	2.34
山村 章	823,200	2.22
JP MORGAN CHASE BANK 385166	530,400	1.43
NOMURA PB NOMINEES LIMITED OMNIBUS-MARGIN (CASHPB)	493,600	1.33

(注) 1.当社は、自己株式93,496株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
2.表示単位未満を切り捨てて表示しております。

所有者別株式分布状況



(注1) 自己株式93,496株は上記の円グラフ中の株式数に含まれていません。
(注2) 表示単位未満を切り捨てて表示しております。

会社概要

商号	株式会社フェローテックホールディングス
(英文表記)	Ferrotec Holdings Corporation
	(平成29年4月1日より、株式会社フェローテックホールディングスに商号変更致しました)
設立	昭和55年9月27日
資本金	175億7,270万2,014円
株式公開	株式会社東京証券取引所 JASDAQ 平成8年10月18日(証券コード:6890)
決算期	3月31日
従業員数	6,536名(連結)

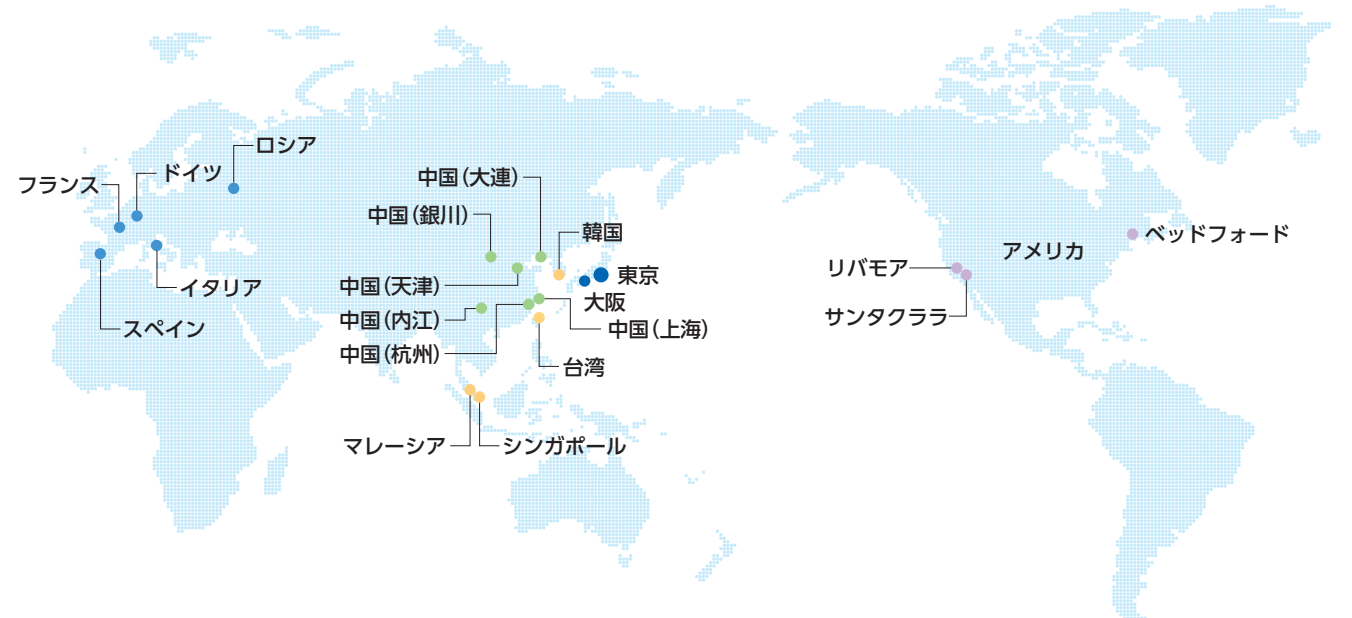
所在地

本社	〒103-0027 東京都中央区日本橋2-3-4 日本橋プラザビル5階
----	---

役員

取締役	氏名
代表取締役社長	山村 章
代表取締役副社長	山村 丈
代表取締役副社長	賀 賢 漢
取締役	若 木 啓 男
取締役	宮 永 英 治
社外取締役	片 山 茂 雄
社外取締役	中 村 久 三
監査役	氏名
常勤社外監査役	樋 口 隆 昌
社外監査役	福 森 久 美
社外監査役	藤 本 豪

グローバルネットワーク



欧州

- フランクフルト (ドイツ)
- シュツットガルト (ドイツ)
- モスクワ (ロシア)
- リヨン (フランス)
- ミラノ (イタリア)
- マドリッド (スペイン)

中国

- 杭州
- 上海
- 銀川
- 天津
- 内江
- 大連

東南アジア

- シンガポール
- 新竹 (台湾)
- ウィワン (韓国)
- タンジン (韓国)
- クアラルンプール (マレーシア)

日本

- 東京 [本社]
- 千葉
- 兵庫
- 石川
- 岡山
- 神奈川

米国

- ベッドフォード
- リバモア
- サンタクララ

● 販売拠点 ● 生産拠点